



光ファイバーセンシングシステム(ひずみ・温度)を用いた 製品開発

名取 孝*・遠藤 正司*

Product Development Using the Optic Fiber Strain and Temperature Sensing System

Takashi Natori* and Masashi Endo*

1. 分布型光ファイバーセンシング

光ファイバーセンシングシステム FBI-Gauge は、光ファイバーを検査品の表面に貼付することで、検査品のひずみ・温度を計測するセンシングシステムである。光ファイバーそのものをセンサーとするため分布型センシングシステムであるため、検査品を連続的に検査できるので、これまで多用されてきたひずみゲージ、熱電対の点での計測に対応に対して、線、面での計測が可能である。

また、大量のひずみゲージ、熱電対を使用することがないので、設置コスト、設置時間の大幅な節減を実現している。

従来の光ファイバーによるひずみ・温度計測の適用例としては、大規模な土木建築物、例えば橋梁、トンネルなどや、航空機、宇宙ロケットなどの長期のヘルスモニタリングなどが挙げられる。一方、空間分解能がミリ単位の分布型センシングシステムを使用すること

により、鉄道車両、自動車などにも適用範囲が広まっていくものと期待される。

FBI-Gauge は計測ハードウェアとして、米国 Luna Technologies 社(以下 Luna 社)が開発した光ファイバーセンシング専用器 ODiSi を使用している。

2. FBI-Gauge の構成

2.1 ODiSI-A50 のシステム構成

ODiSI-A50 本体、ノート PC、本体—PC 接続用 USB ケーブル、専用接続光ケーブルで構成される。本体と専用接続光ケーブル間は SC/APC コネクターで接続され、専用接続光ケーブルと計測用ファイバー間は LC/APC コネクターで接続される。専用接続光ケーブルは長さ 10 m で、計測用ファイバーは 1 m から 50 m の長さのものが用意されている。ゲージ長(測定ピッチ)は 1 mm であり、測定タイミングは 2.5 Hz から 5 Hz まで設定できる。

2.2 ODiSI-B10 のシステム構成

ODiSI-B10 本体、デスクトップ PC、本体—PC 接続用 PCIe Express ケーブル、専用接続光ケーブルで構成される。本体と専用接続光ケーブル間はデュアル LC/APC コネクターで接続され、専用接続光ケーブルと計測用ファイバー間は LC/APC コネクターで接続される。専用接続光ケーブルは長さ 50 m で、計測用ファイバーは 1 m から 10 m の長さのものが用意されている。ゲージ長(測定ピッチ)は 5 mm であり、測定タイミングは 100 Hz まで設定できる。

3. 片持ちカンチレバーによる実例

従来のひずみゲージとの精度検証、および、有限要

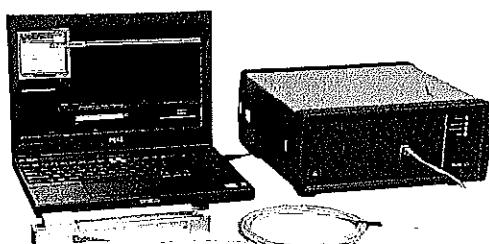


図 1 FBI-Gauge(ODiSI-A50)

* 株式会社富士テクニカルリサーチ
Fuji Technical Research Inc.

素法による解析結果と比較を実施して、本システムの有効性を確認した。光ファイバーはひずみゲージなどと同様に接着剤を使用して設置する場合が一般的である。測定結果については、ひずみゲージと精度的には全く同等であることが確認できた。また、有限要素法

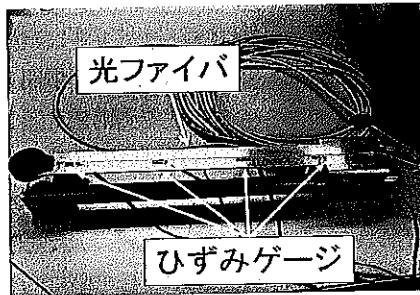


図2 カンチレバー

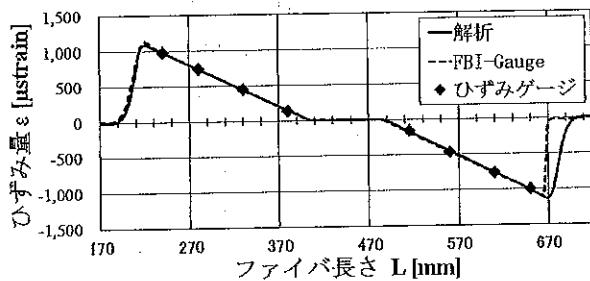


図3 カンチレバー計測結果

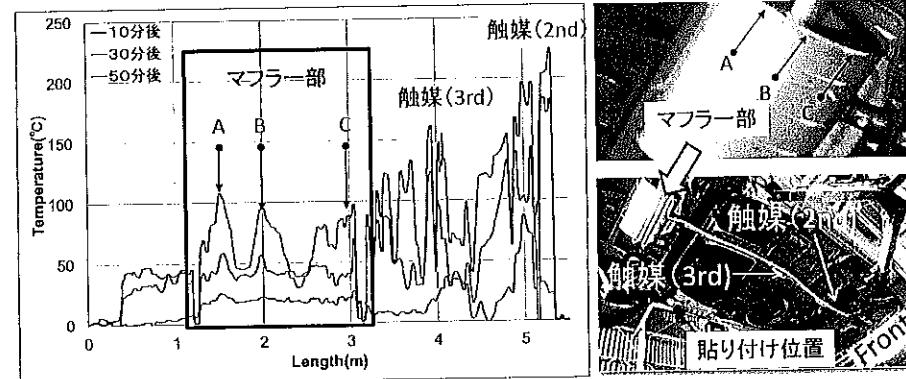


図4 排気温度計測結果

による解析結果とも良く一致している。本システムを使用することにより、従来の点でのひずみ認識から、線・面でのひずみ分布の測定が可能なことを示すことができた。

4. 自動車への光ファイバーへの実施例について

実際に自動車の底面の熱分布を測定した例を以下に報告する。エンジンの排気システムの熱分布を把握するために、エキゾーストパイプからメインマフラーの表面に光ファイバーをエポシキ系接着剤で固定し、20分間のアイドリング運転後に、10分間の2000回転での運転後、エンジン停止後30分間放置した場合の、メインマフラー部、触媒部の温度履歴を測定した。

エンジンの排気温度は、エンジン排出後では900度程度まで上昇するが、マフラー表面では100度程度まで低下していることが分かった。

このように、本システムを使用することによって、熱の測定においても、従来の熱電対を使用した測定では不可能だった、線・面での温度分布の計測が可能であることが示された。今後は、熱管理が重要な各製造工程、特に金型の温度管理などに本システムを使用することにより、より精度が良い製品開発が可能になるものと期待される。